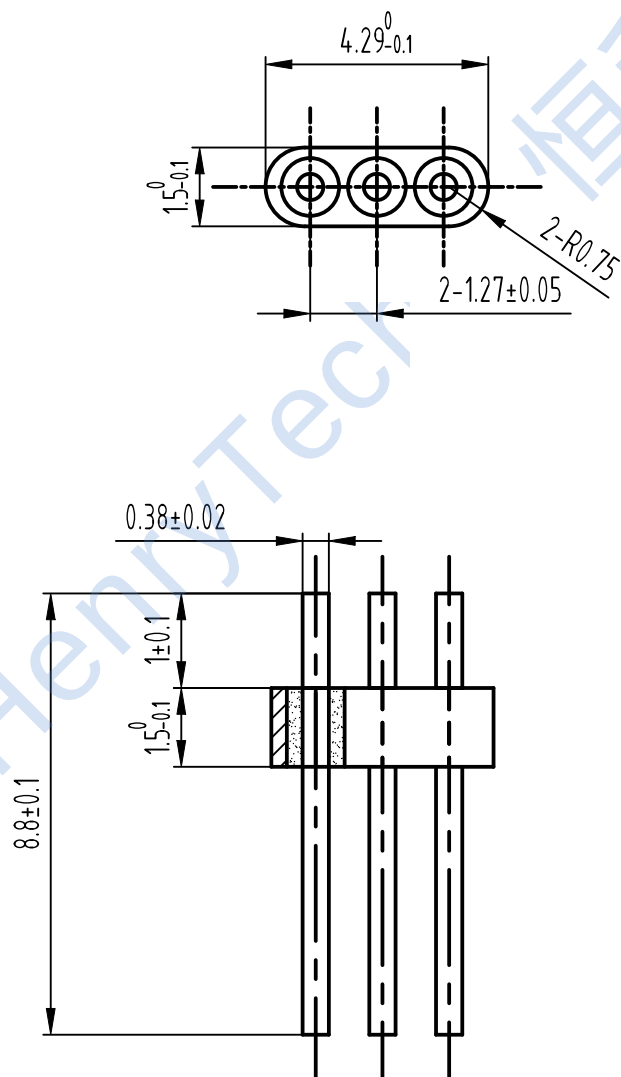




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013\times10^{-3}Pa \cdot cm^3 / S$
4. 使用寿命： $\geq 500$ 次
5. 温度范围： $-65 \sim +155$
6. 镀层厚度： $\geq 1.27\mu m$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP3-0.38-1.27(8.8-1)  
M

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司  
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

|    |    |       |     |    |  |      |   |  |    |   |     |  |
|----|----|-------|-----|----|--|------|---|--|----|---|-----|--|
|    |    |       |     |    |  | 图样标记 |   |  | 重量 |   | 比例  |  |
|    |    |       |     |    |  |      |   |  |    |   |     |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期 |  |      |   |  |    |   | 7:1 |  |
| 设计 | M. |       | 标准化 |    |  |      |   |  |    |   |     |  |
| 审核 |    |       |     |    |  |      |   |  |    |   |     |  |
| 工艺 |    |       | 日期  |    |  | 共    | 页 |  | 第  | 页 |     |  |